

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Старший инженер 512 ВП МО РФ

А.Р. Чириченко

« » 2019г.

Заместитель директора
по инновационной деятельности
НПК «Технологический центр»

В.Г. Сницар

« 13 » 11 2019г.

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ

5529TP104, 5529TP104A

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТ

ГАВЛ.431268.021Д1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
17797				

Главный конструктор изделия

А.Н. Денисов

« 13 » 11 2019г.

**НАЗНАЧЕНИЕ, СХЕМО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ,
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.**

Микросхемы интегральные 5529TP104, 5529TP104A представляют собой многофункциональные цифровые матрицы, выполненные по полупроводниковой технологии на МОП-транзисторах.

Микросхемы предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения. Количество элементов в схеме электрической (количество эквивалентных вентилей), не менее - 16960000 (4240000).

Конструктивное исполнение для микросхемы 5529TP104 в корпусе МК 4254.352-2 приведено на рисунке 1, для микросхемы 5529TP104A в корпусе МК 4251.304-2 приведено на рисунке 2.

Схема электрическая структурная микросхемы представлена на рисунке 3. Схема электрическая структурная периферийной ячейки приведена на рисунке 4.

Электрические параметры микросхемы приведены в таблице 1. Предельные и предельно-допустимые значения электрических режимов эксплуатации микросхемы приведены в таблице 2.

Таблицы назначения выводов микросхем приведены в картах заказа соответствующих регистрационных номеров.

Пример обозначения микросхем при заказе (в договоре на поставку):

- микросхема 5529TP104-X¹⁾ – АЕНВ.431260.290ТУ, корпус МК 4254.352-2, карта заказа²⁾;
- микросхема 5529TP104A-X¹⁾ – АЕНВ.431260.290ТУ, корпус МК 4251.304-2, карта заказа²⁾;

¹⁾ X – Регистрационные номера карт заказа (цифровые или буквенно-цифровые коды), указанные в обозначении полузаизных микросхем на основе БК в соответствии с АЕНВ.431260.290ТУ.

²⁾ Децимальные номера карт заказа в соответствии с АЕНВ.431260.290ТУ.

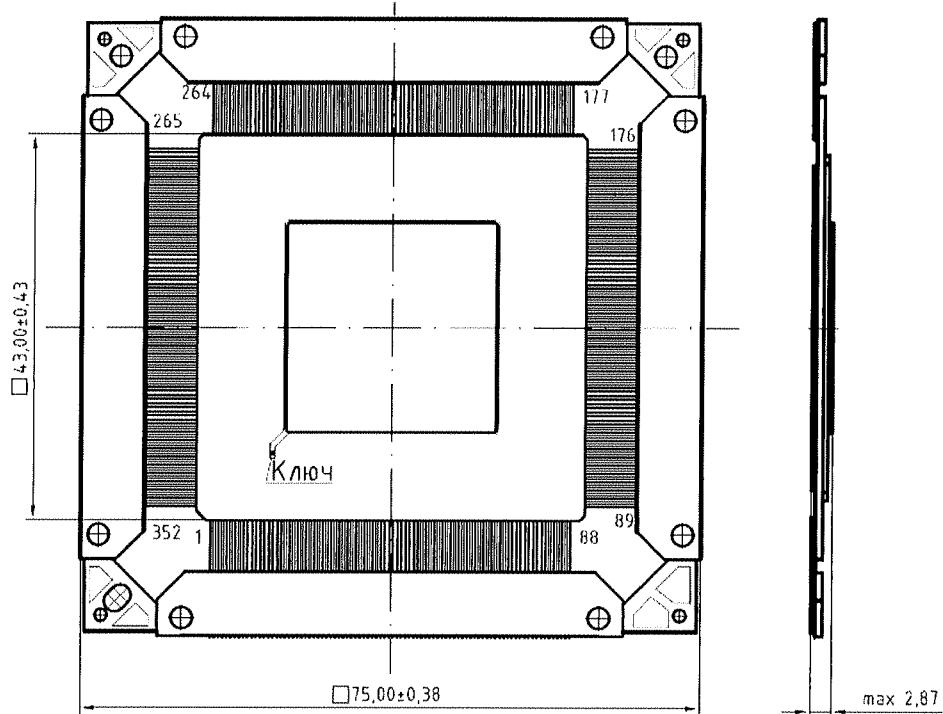
Перв. примен.	ГАВЛ.431268.021		
Стр. №			
Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. №	Подл. и дата
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Астахова	Соф	13.11.19
Пров.	Тикашкин	Вит	13.11.19
Н. контр.	Казаков	Андр	13.11.19
Утв.	Денисов	Сергей	13.11.19

ГАВЛ.431268.021Д1

Микросхемы интегральные
5529TP104, 5529TP104A
Справочный лист

Лит.	Лист	Листов
A	2	29

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



Знак чувствительности микросхем к СЭ обозначен равносторонним треугольником (Δ). Первый вывод микросхемы находится в левом нижнем углу корпуса. Левый нижний угол определяется по фаске на корпусе. Первым выводом является левый нижний вывод корпуса. Нумерация выводов – против часовой стрелки.

Нумерация выводов показана условно.

Рисунок 1 – Микросхема интегральная 5529TP104

Корпус МК 4254.352-2

Металлокерамический

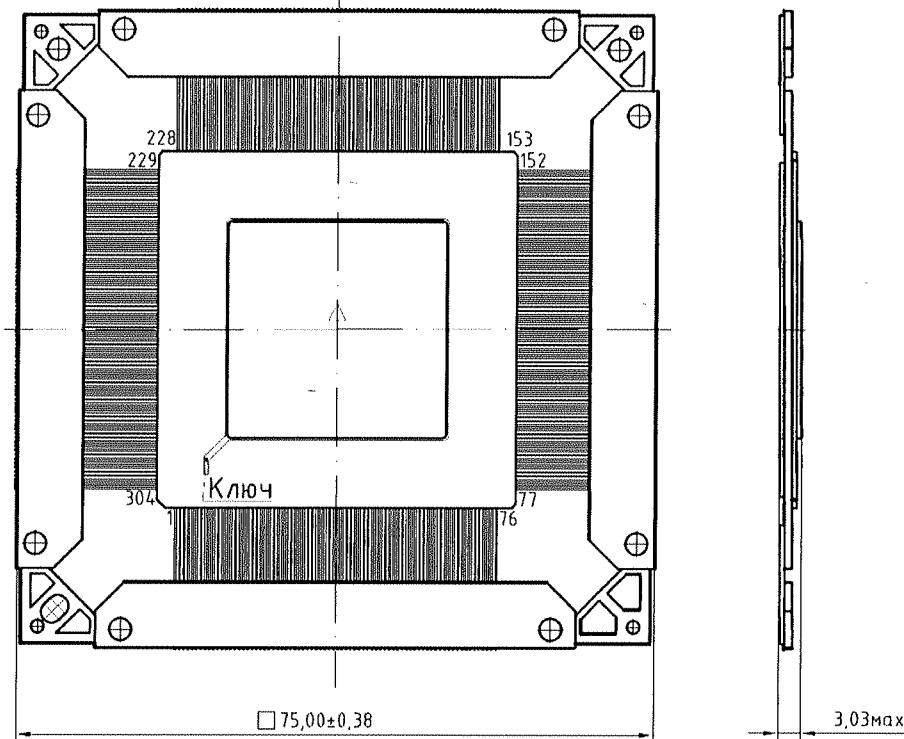
Материал покрытия выводов: золото

Общее содержание драгметаллов в готовом изделии соответствует данным этикетки ГАВЛ.431268.021ЭТ.

Масса микросхемы не должна превышать 29,0 г.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм. 1	Дат. 10.01.00			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.021Д1	Лист
						3



Знак чувствительности микросхем к СЭ обозначен равносторонним треугольником (Δ). Первый вывод микросхемы находится в левом нижнем углу корпуса. Левый нижний угол определяется по фаске на корпусе. Первым выводом является левый нижний вывод корпуса. Нумерация выводов – против часовой стрелки.

Нумерация выводов показана условно.

Рисунок 2 – Микросхема интегральная 5529TP104А

Корпус МК 4251.304-2

Металлокерамический

Материал покрытия выводов: золото

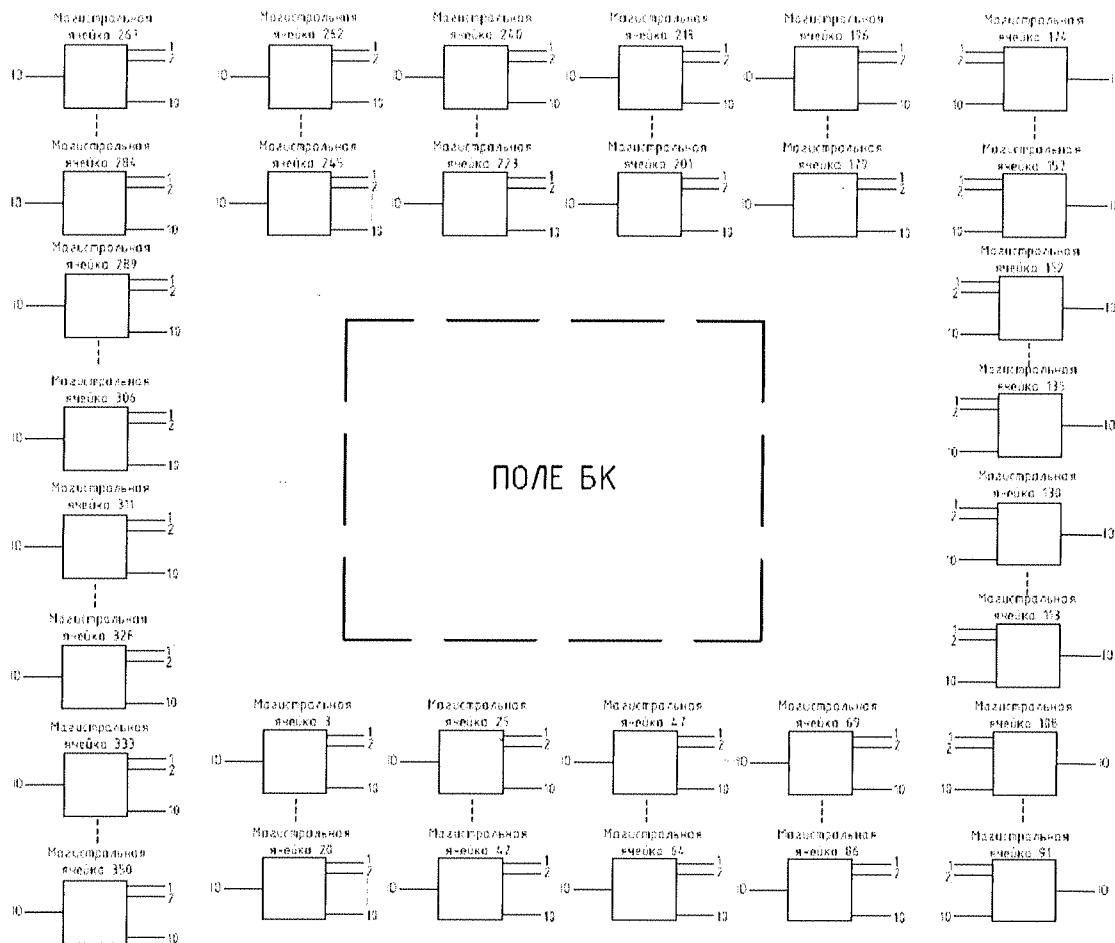
Общее содержание драгметаллов в готовом изделии соответствует данным этикетки ГАВЛ.431268.021-01ЭТ.

Масса микросхемы не должна превышать 23,0 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подп. и дата
И.Ю.Ч	Дат подл. 01.01.20			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.021Д1	Лист
						4

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА



- Нумерация выводов ячеек приведена условно. Обозначения выводов приведены в соответствующей регистрационному номеру карте заказа.
- Нумерация ячеек поля соответствует номеру столбца ячеек в поле микросхемы и порядковому номеру в столбце.
- Магистральные ячейки 1, 2, 22, 23, 44, 45, 66, 67, 87, 88, 110, 111, 132, 133, 154, 155, 177, 178, 198, 199, 220, 221, 242, 243, 263, 264, 286, 287, 308, 309, 330, 331(на схеме не показаны) соответствует контакту «Земля».
- Магистральные ячейки 21, 24, 43, 46, 65, 68, 89, 90, 109, 112, 131, 134, 153, 156, 175, 176, 197, 200, 219, 222, 241, 244, 265, 266, 285, 288, 307, 310, 329, 332, 351, 352(на схеме не показаны) соответствует контакту «Питание»

Рисунок 3 - Схема электрическая структурная микросхем 5529TP104, 5529TP104A

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
177.9.У	Лист 3 из 30			

ГАВЛ.431268.021Д1



Рисунок 4 – Схема электрическая структурная периферийной ячейки

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ГАВЛ	07.02.2020			

ГАВЛ.431268.021Д1

ДОПУСТИМЫЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Механические факторы

1 Синусоидальная вибрация	
Диапазон частот, Гц	1 – 5000
Амплитуда ускорения, м/с ² (g)	400 (40)
2 Удары одиночного действия в любом направлении	
Амплитуда пикового ударного ускорения, м/с ² (g)	15000 (1500)
Длительность действия ударного ускорения, мс	0,1 – 2,0
3 Удары многократного действия в любом направлении	
Амплитуда пикового ударного ускорения, мс (g)	1500 (150)
Длительность действия ударного ускорения, мс	1–5
4 Линейное ускорение в любом направлении	
Амплитуда линейного ускорения, м/с ² (g)	5000 (500)
5 Акустический шум	
Диапазон частот, Гц	50 – 10000
Уровень звукового давления (относительно 0,00002 Па), дБ	170

Климатические факторы

1 Атмосферное пониженное рабочее давление, Па (мм рт. ст.)	$1,3 \times 10^{-4} (10^{-6})$
2 Повышенное рабочее давление, кПа(мм рт. ст.)	294(2205)
3 Повышенная температура среды: рабочая, °C	+85
предельная, °C	+125
4 Пониженная температура среды: рабочая, °C	минус 60
предельная, °C	минус 60
5 Смена температур: от пониженной предельной температуры среды, °C	минус 60
до повышенной предельной температуры среды, °C	+125
6 Повышенная относительная влажность при 35°C, %	98*

Вид исполнения по ГОСТ РВ 20.39.414.1

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
1493	2018.01.30			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					7

7 Атмосферные конденсированные осадки (роса, иней)	*
8 Соляной (морской) туман	*
9 Плесневые грибы	
10 Статическая пыль	**
11 Контрольные среды (среды заполнения), объемная доля компонентов контрольной среды, %	
гелиево-воздушная	90
аргоно- воздушная	90
аргоно- азотная	90

*Соответствие микросхем данному требованию обеспечивается при условии их многослойного лакового покрытия в составе аппаратуры.

**Требования по устойчивости к воздействию статической пыли не предъявляются.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
И.У.Г.Ч	Д.Н.А.Л.О.Д.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.021Д1

Лист

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон напряжения питания U_{CC} микросхем должно быть от 2,70 В до 3,63 В.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Таблица 1 – Электрические параметры микросхем при приёмке и поставке

Наименование параметра, обозначение единицы физической величины, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура среды, °C
		не менее	не более	
1 Выходное напряжение низкого уровня, В при $U_{CC}=2,7$ В, I_{OL} от 1 до 12,0 мА	U_{OL}	-	0,3	+25±10 -60 +85
2 Выходное напряжение высокого уровня, В при $U_{CC}=2,7$ В, I_{OH} от 1 до 12,0 мА	U_{OH}	$U_{CC}-0,3$	-	+25±10 -60 +85
3 Ток потребления статический, мА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=U_{CC}$, $U_{IL}=0$ В	I_{CC}	-	10,0 ²⁾ 30,0 ²⁾	+25±10 -60 +85
4 Токи утечки низкого и высокого уровней на входе, мкА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=U_{CC}$, $U_{IL}=0$ В	I_{ILL}, I_{ILH}	-1,0 -3,0	1,0 3,0	+25±10 -60 +85
5 Выходной ток низкого и высокого уровней в состоянии «Выключено» на выводах выход (вход/выход), мкА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{OZH}(U_{IOZH})=U_{CC}$, $U_{OZL}(U_{IOZL})=0$ В	I_{OZL}, I_{OZH}	-1,0 -3,0	1,0 3,0	+25±10 -60 +85
6 Ток доопределения внешнего вывода до низкого уровня, мА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=U_{CC}$, $U_{IL}=0$ В	I_{RL}	0,005	2,0	+25±10 -60 +85
7 Ток доопределения внешнего вывода до высокого уровня, мА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=U_{CC}$, $U_{IL}=0$ В	I_{RH}	0,005	2,0	+25±10 -60 +85

Окончание таблицы 1

Наименование параметра, обозначение единицы физической величины, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температу- ра среды, °C
		не менее	не более	
8 Время задержки на вентиль ³⁾ , пс при $U_{CC}=3,63$ В, $C_L \leq 150$ пФ	t_{DB}	-	60,0	+25±10
			100,0	-60 +85
9 Входная ёмкость, пФ	C_I	-	7,0	+25±10
			10,0	-60 +85
10 Выходная ёмкость, пФ	C_O	-	7,0	+25±10
			10,0	-60 +85
11 Ёмкость входа/выхода, пФ	$C_{I/O}$	-	7,0	+25±10
			10,0	-60 +85

¹⁾ Погрешность задания температуры составляет ± 3 °C.

²⁾ Значения могут быть уточнены в карте заказа.

³⁾ В карте заказа могут устанавливаться другие динамические параметры с указанием метода контроля.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Т а б л и ц а 2 – Предельно-допустимые и предельные электрические режимы эксплуатации микросхем

Наименование параметра, обозначение единицы физической величины, режим измерения	Буквен- ное обозна- чение парамет- ра	Предельно- допустимый режим		Предельный режим	
		не менее	не более	не менее	не более
1 Напряжение питания, В	U_{CC}	2,7	3,63	-0,4	4,0
2 Напряжение, прикладываемое к выводу закрытой микросхемы, В	U_{OZ}	0,0	U_{CC}	-0,4	$U_{CC}+0,4$, но не более 4,0
3 Входное напряжение низкого уровня, В	U_{IL}	0,0	0,4	-0,4	-
4 Входное напряжение высокого уровня, В	U_{IH}	($U_{CC}-0,4$)	U_{CC}	-	$U_{CC}+0,4$, но не более 4,0
5 Выходной ток низкого уровня, мА	I_{OL}	-	12,0	-	24,0

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. №	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лист
Изм. 1/2/4	Мережко А.С.					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		10

Окончание таблицы 2

Наименование параметра, обозначение единицы физической величины, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимый режим		Предельный режим	
		не менее	не более	не менее	не более
6 Выходной ток высокого уровня, мА	I _{OH}	-	12,0	-	24,0
7 Емкость нагрузки, пФ	C _L	-	150,0	-	250,0

НАДЕЖНОСТЬ

Наработка до отказа в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых АЕИВ.431260.290ТУ, должна быть не менее 140 000 ч при температуре окружающей среды не более $(65 + 5)^\circ\text{C}$ и не менее 200 000 ч в облегченном режиме при $U_{CC} = 3,0 \text{ В} \pm 5\%$, выходные токи I_{OL} , I_{OH} не более 50 % от предельно-допустимый значений, установленных в таблице 2.

Гамма – процентный срок сохраняемости ($T_{Cs\gamma}$) микросхем при $\gamma = 99\%$ при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемыми влажностью и температурой, или в местах хранения микросхем, вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплексе ЗИП, должен быть – 25 лет. Требования к показателям безотказности действуют в пределах срока службы $T_{сл}$, устанавливаемого численно равным $T_{Cs\gamma}$.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подп. и дата
1392	АКР 29.07.00			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	GAVL.431268.021Д1	Лист
						11

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Порядок подачи и снятия напряжений питания и входных сигналов на микросхемы должен быть следующим:

- при включении на микросхемы сначала подается напряжение питания U_{CC} , а затем входные напряжения U_I , или одновременно;
- при выключении напряжение питания U_{CC} снимается последним или одновременно с входными напряжениями U_I .

Допускается работа микросхем при ёмкости нагрузки C_L до 250 пФ. При этом динамические параметры не гарантируются.

Неиспользуемые выводы микросхем допускается подключать к шине общего вывода GND (0 В) или к шине напряжения питания U_{CC} .

Допустимое значение потенциала СЭ – не более 2000 В при использовании стандартных периферийных ячеек и не более 1000 В при использовании периферийных ячеек без верхнего защитного диода, что указывается в карте заказа.

Нумерацию, обозначение, наименование выводов, дополнительные указания к этапу разработки аппаратуры приводят в картах заказа.

Рекомендуется установку и крепление микросхем на платы проводить в соответствии с рисунком 5. Вид формовки микросхем - в соответствии с рисунком 6.

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре операциями пайки по ОСТ 11 073.063 при установке их на некерамические платы. Допустимое количество исправлений дефектов пайки отдельных выводов микросхемы – не более двух.

Способ установки микросхем на платы и их демонтажа должен обеспечивать отсутствие передачи усилий, деформирующих корпус.

Рекомендуется начинать пайку с выводов V_{CC} и GND (0 В). Пайку остальных выводов разрешается проводить в любой последовательности.

Устанавливать и извлекать микросхемы из контактных приспособлений, а также производить замену микросхем необходимо только при снятии напряжений со всех выводов микросхемы.

В непосредственной близости между выводами U_{CC} и выводами GND (0 В), указанными в картах заказа, должны быть подключены керамические конденсаторы емкостью не менее 0,3 мкФ и рабочим напряжением не менее 10 В. Необходимое количество и номиналы конденсаторов определяются разработчиком аппаратуры.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подл. и дата
1494	Декабрь 2000			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					12

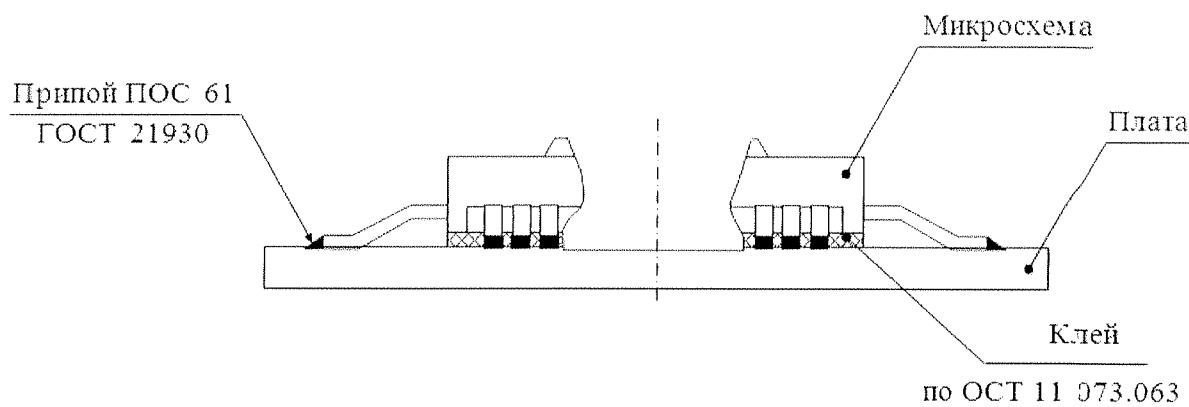


Рисунок 5 – Пример установки и крепления микросхем 5529TP104, 5529TP104A на плате

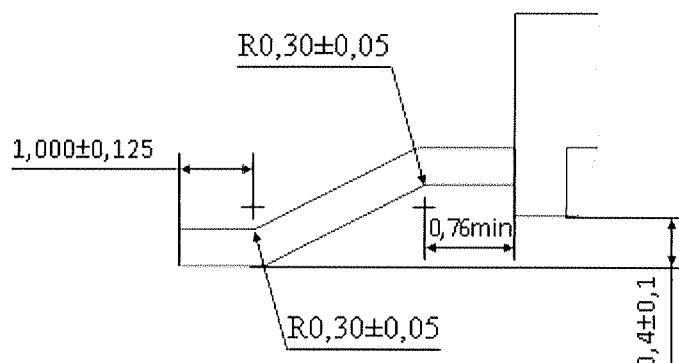
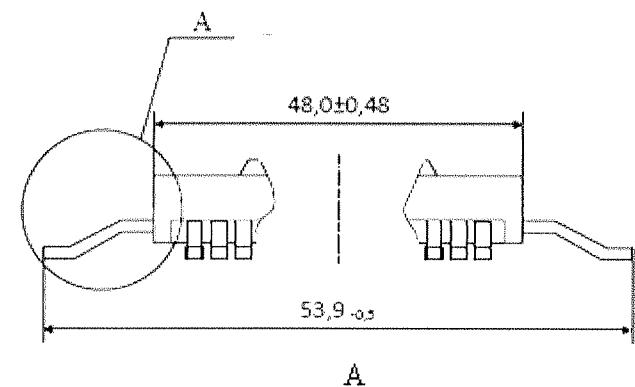


Рисунок 6 – Рекомендуемый вид формовки и обрезки выводов микросхем 5529TP104

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
ГАВЛ.431268.021Д1	Дек. 2020			

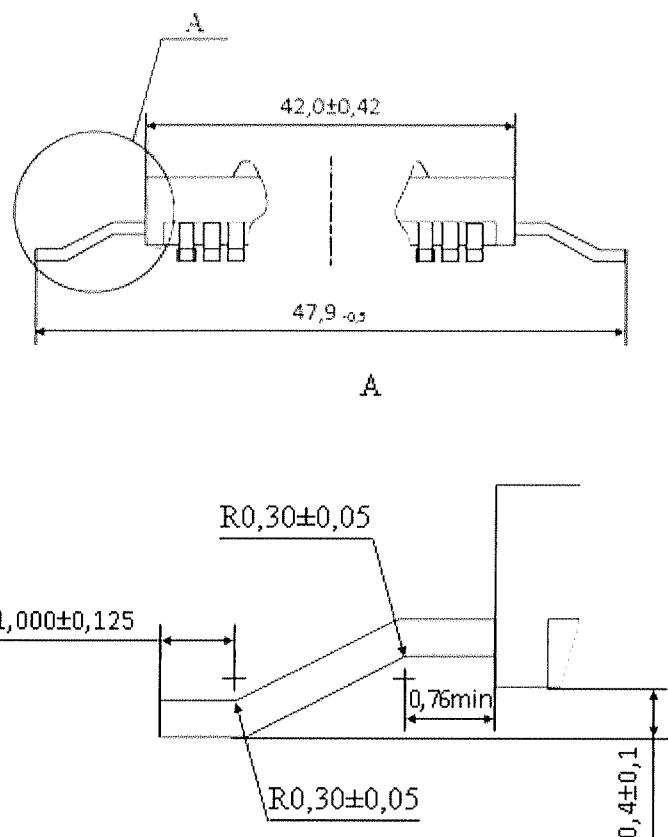


Рисунок 7 – Рекомендуемый вид формовки и обрезки выводов микросхем

5529TP104A

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1797	Д.А.О. 20			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.021Д1	Лист
						14

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

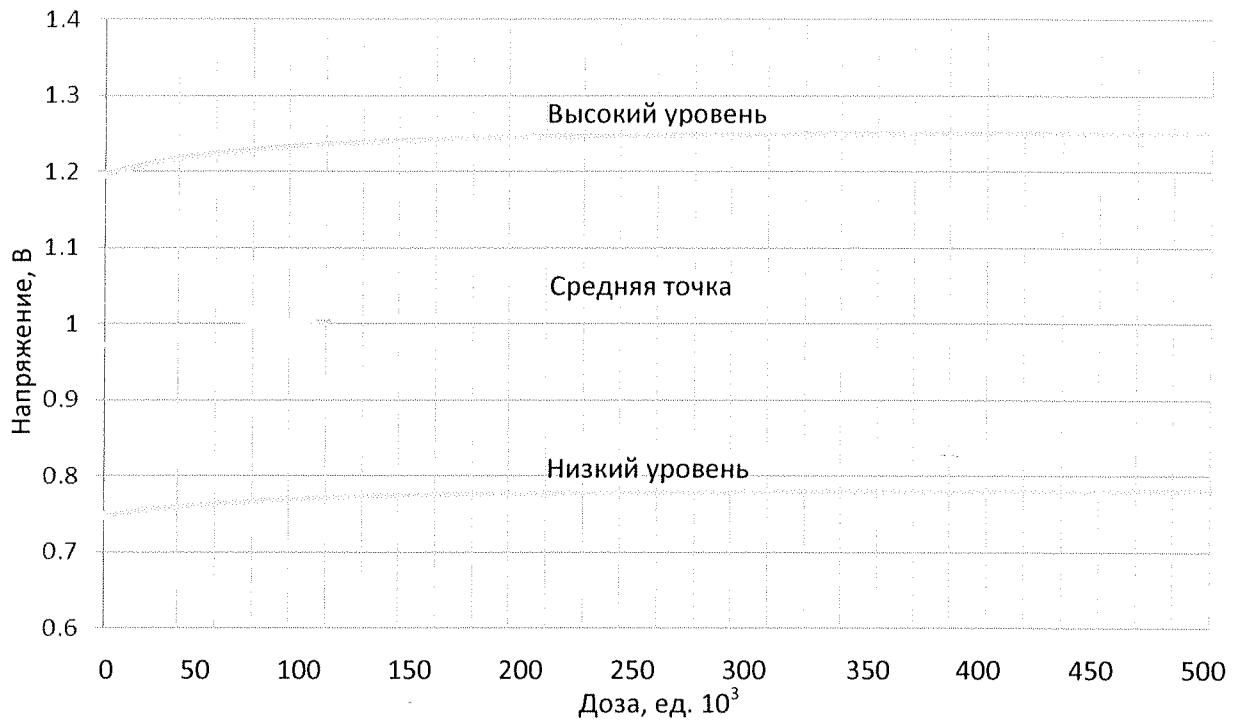


Рисунок 8 – Зависимости уровней выходного сигнала M-LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 2,7$ В

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1397	27.02.2020			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					15

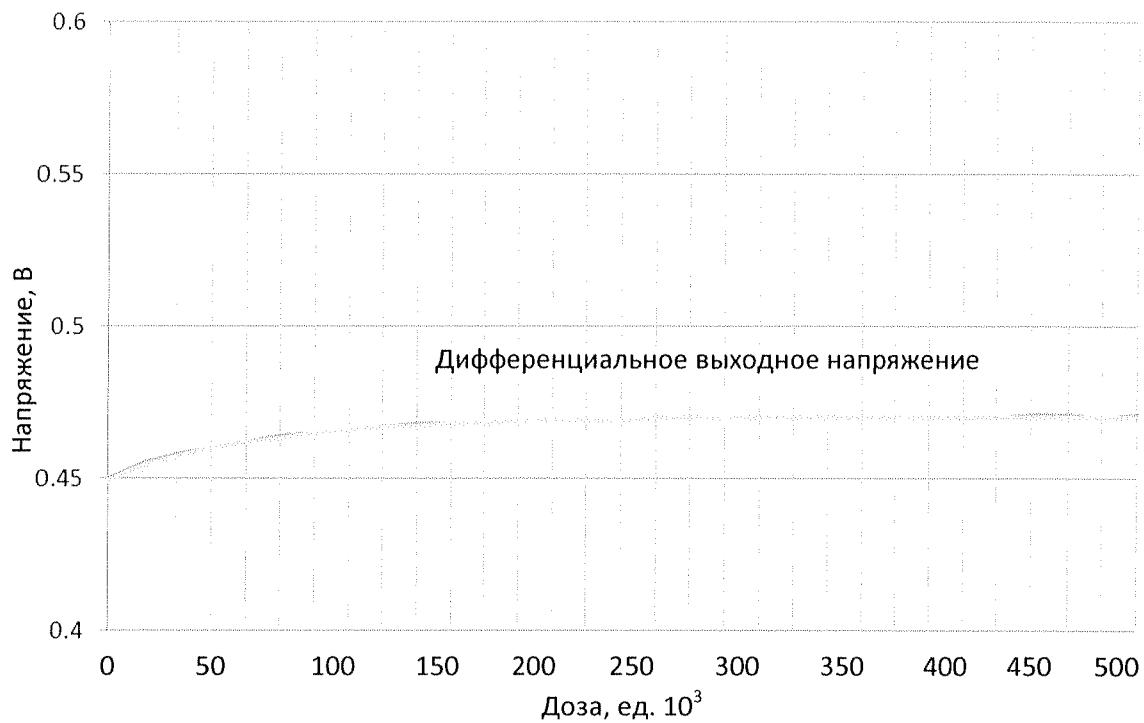


Рисунок 9 – Зависимости дифференциального выходного сигнала М–LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 2,7$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ИЧУ	Д.А.С.О.С.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.021Д1

Лист

16

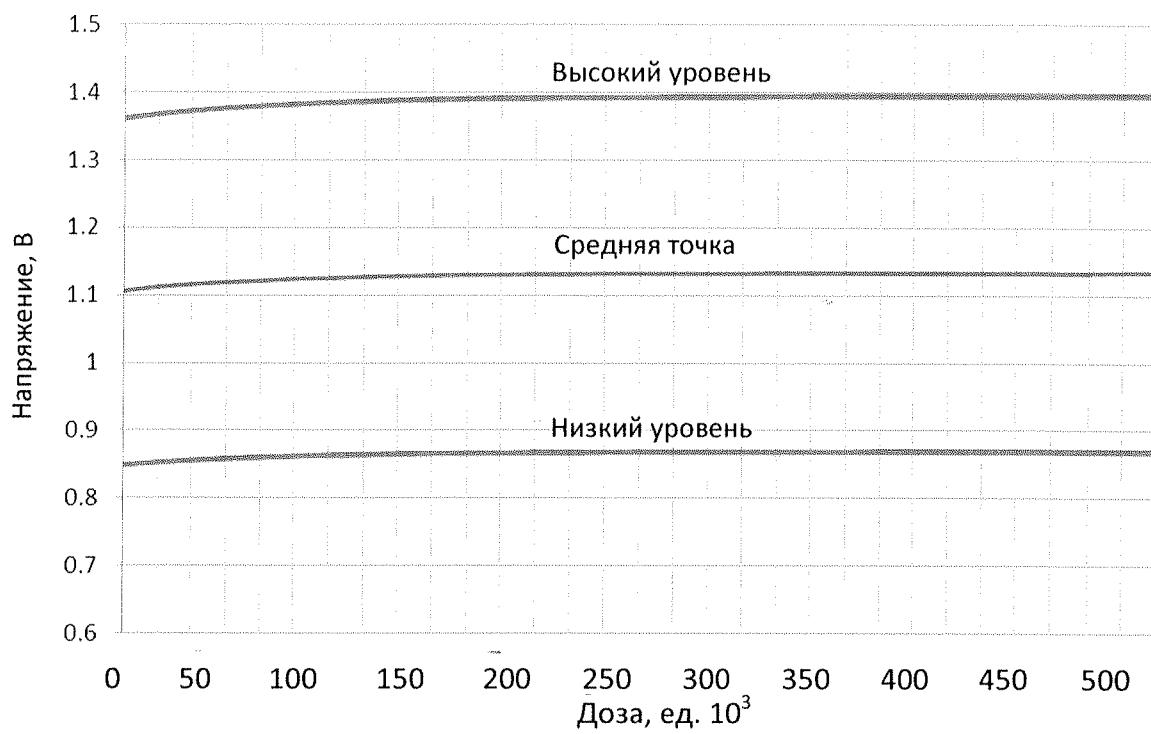


Рисунок 10 – Зависимости уровней выходного сигнала M-LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,0$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
13.97	12.01.2020			

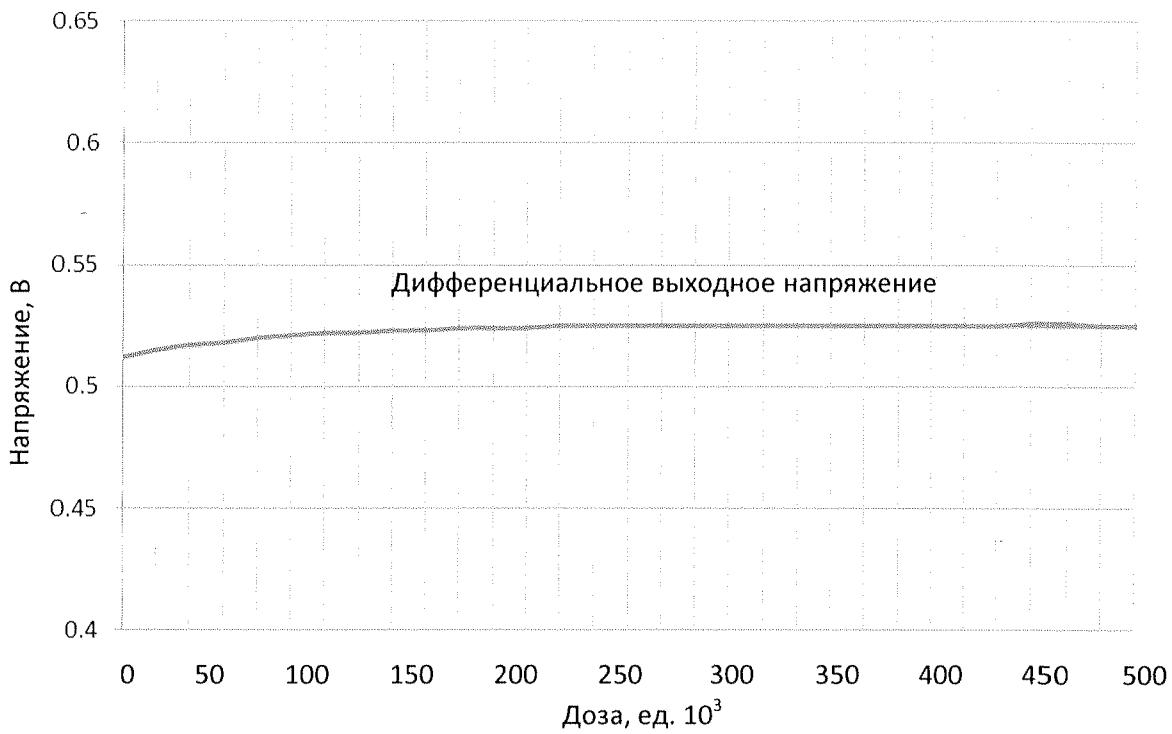


Рисунок 11 – Зависимости дифференциального выходного сигнала М–LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,0$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1499	А.А.О.и.о.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.021Д1

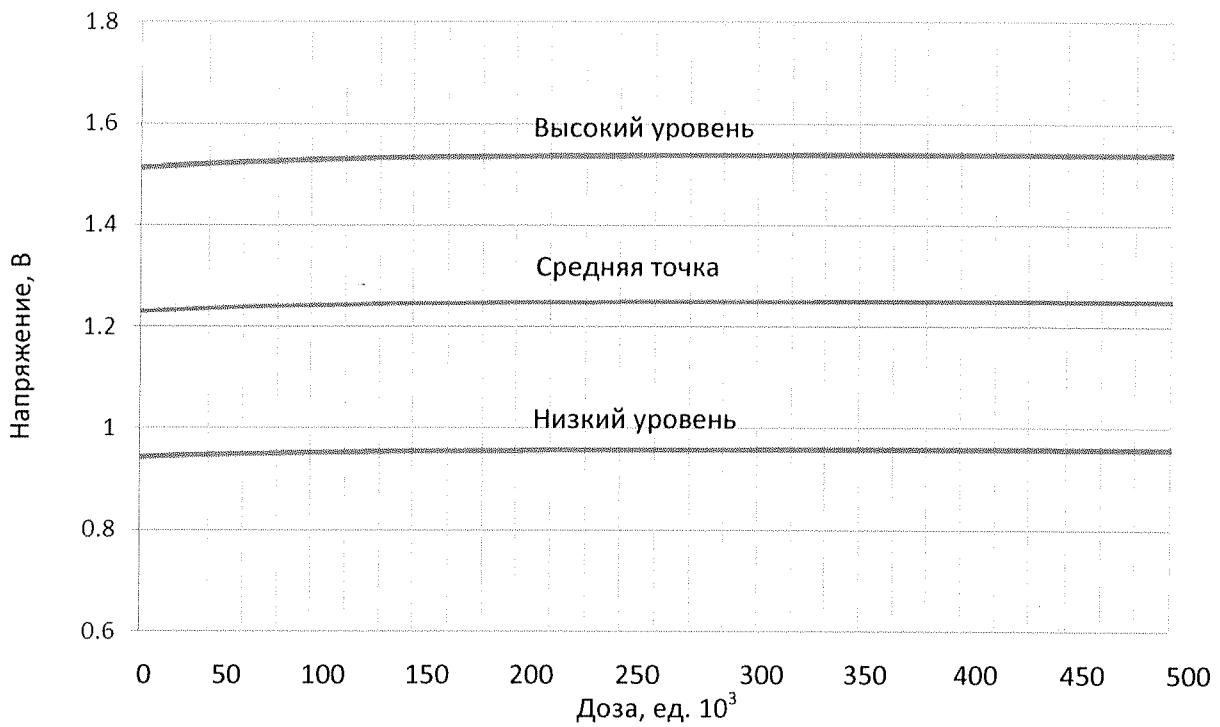


Рисунок 12 – Зависимости уровней выходного сигнала M-LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,3$ В

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ГАВЛ.431268.021Д1	Ильин О.О.			

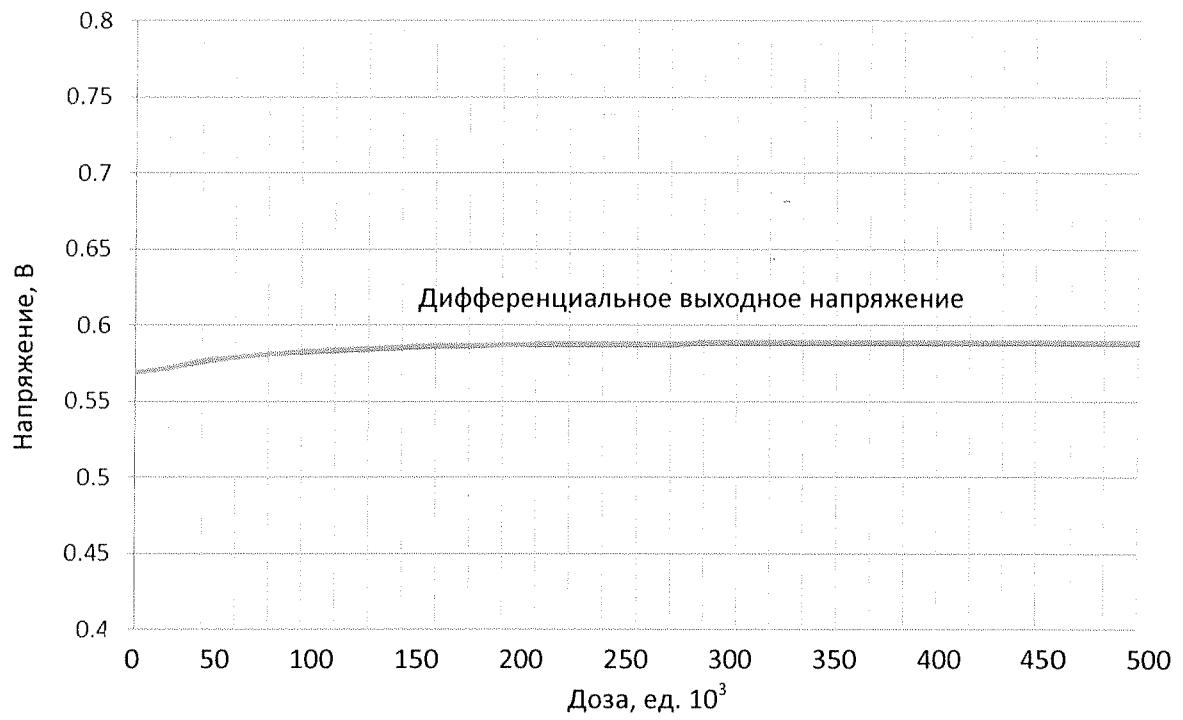


Рисунок 13 – Зависимости дифференциального выходного сигнала M-LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,3$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1497	Дат подл. 01.10.			

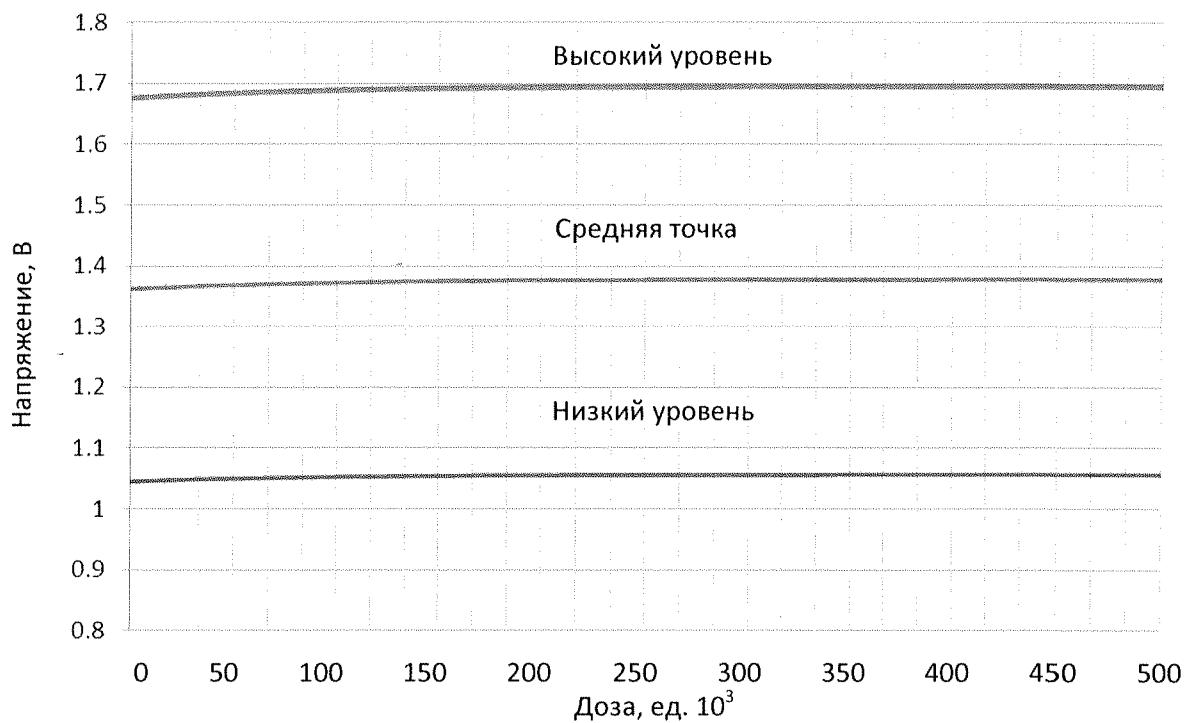


Рисунок 14 – Зависимости уровней выходного сигнала M–LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,63$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
14.97	Лит. А			

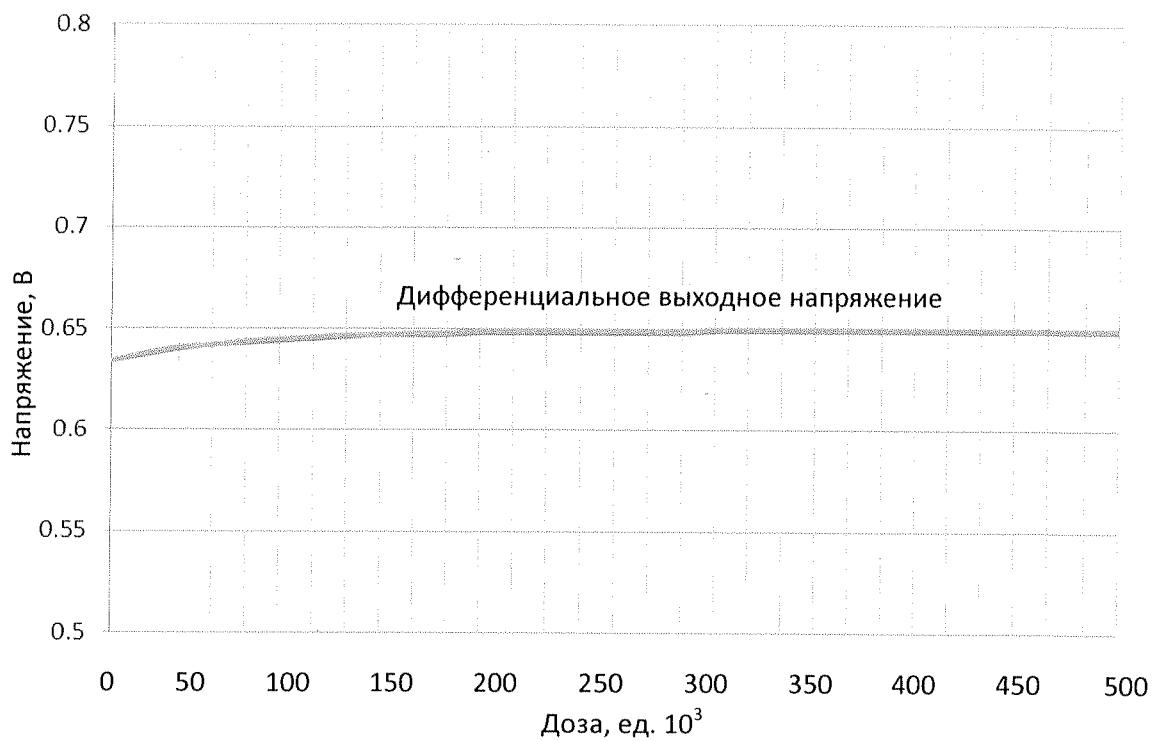


Рисунок 15 – Зависимости дифференциального выходного сигнала М–LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,63$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ГУГЧ	Петров А.А.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.021Д1	Лист
						22

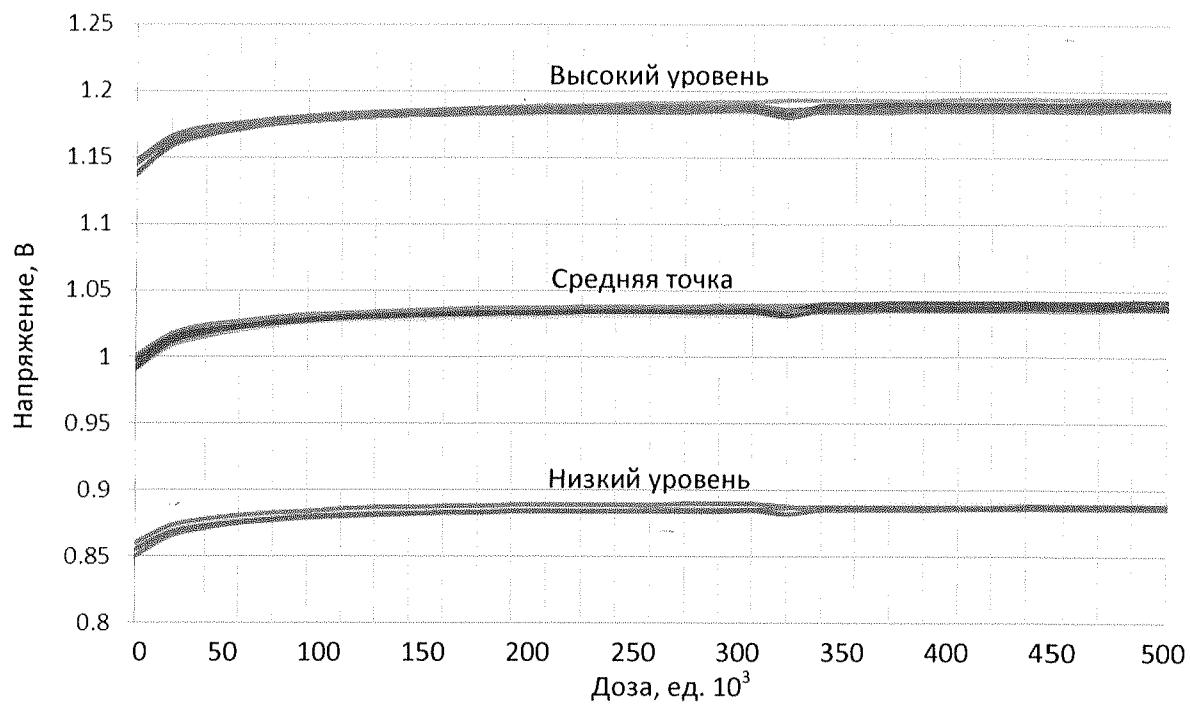


Рисунок 16 – Зависимости уровней выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 2,7$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
И.И.И.	И.И.И. И.И. И.			

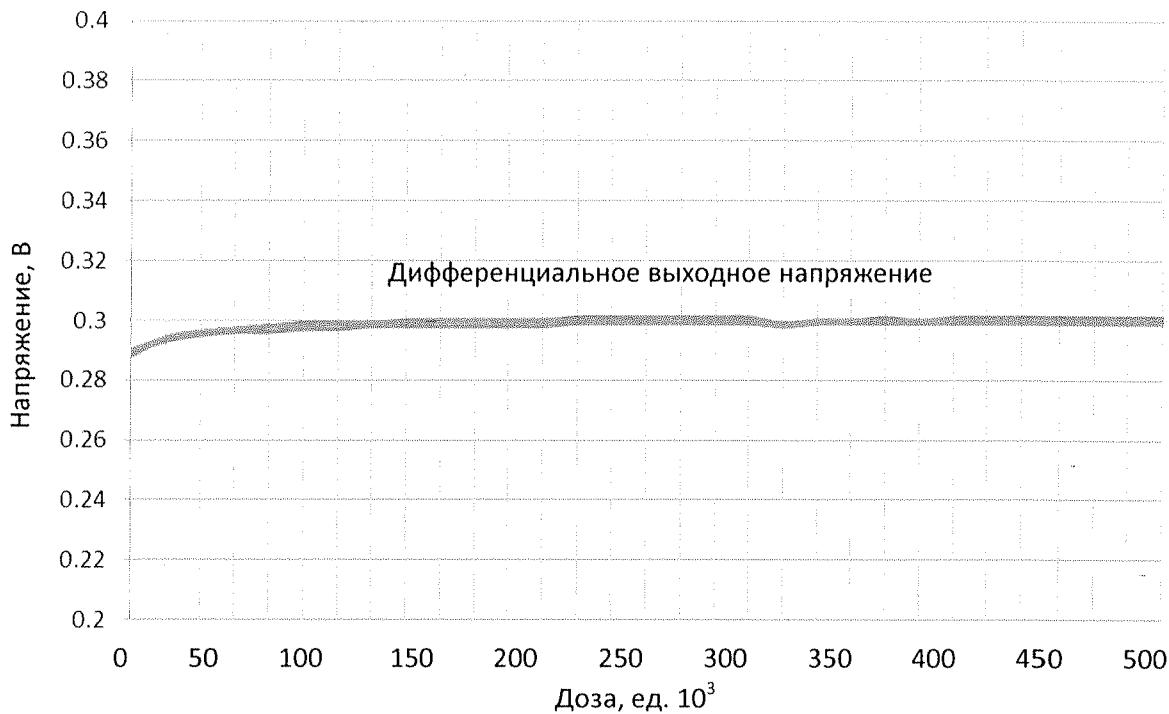


Рисунок 17 – Зависимости дифференциального выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 2,7$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ИИ.02	Ильин. О.А.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.021Д1

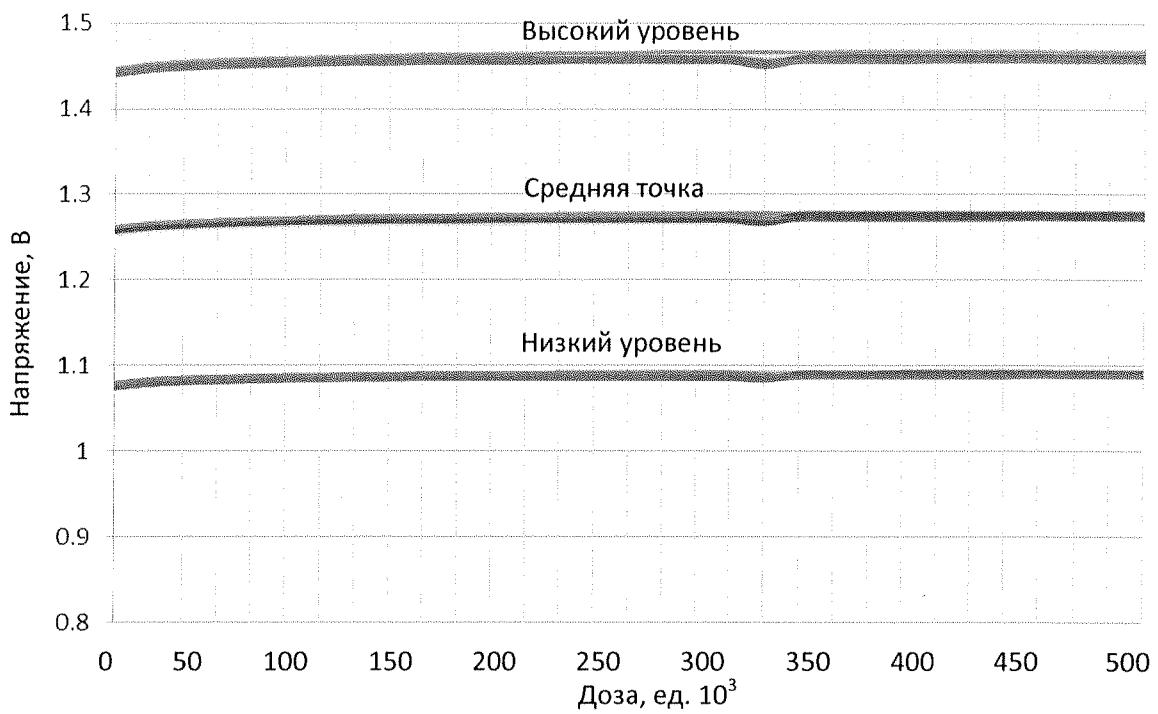


Рисунок 18 – Зависимости уровней выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,3$ В

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм. 129	Алехин А.Н.			

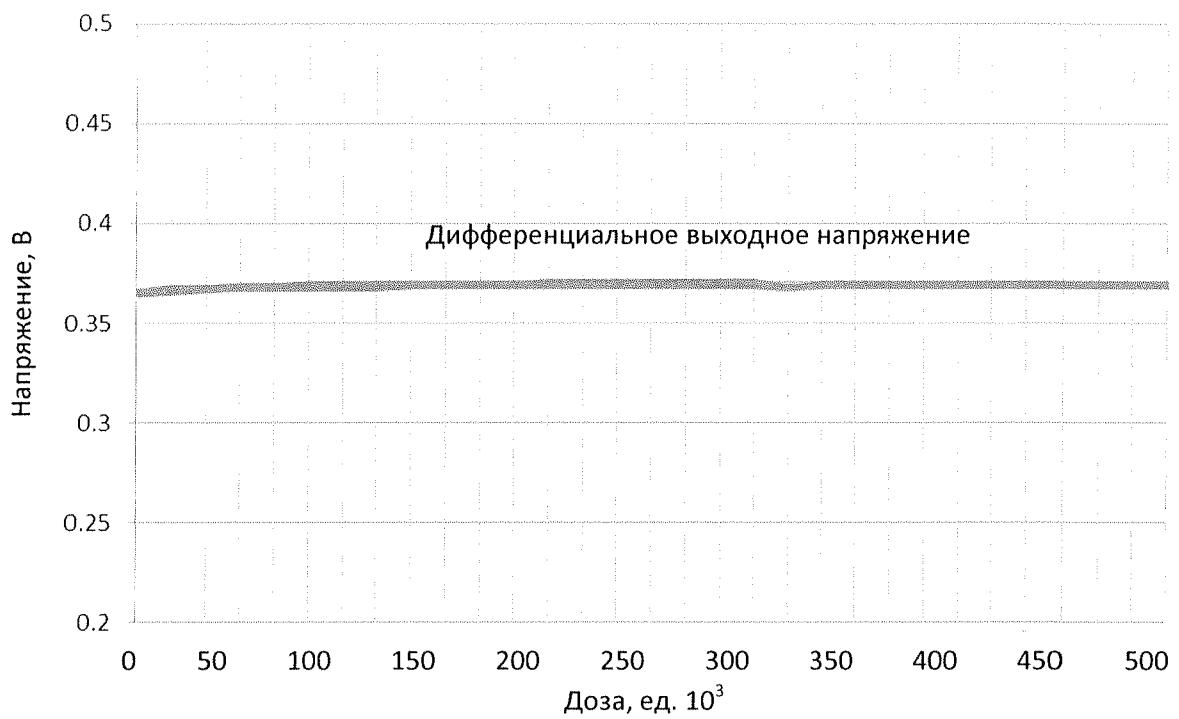


Рисунок 19 – Зависимости дифференциального выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,3$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
И.У.Ф	Д.А.Д.К.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.021Д1

Лист
26

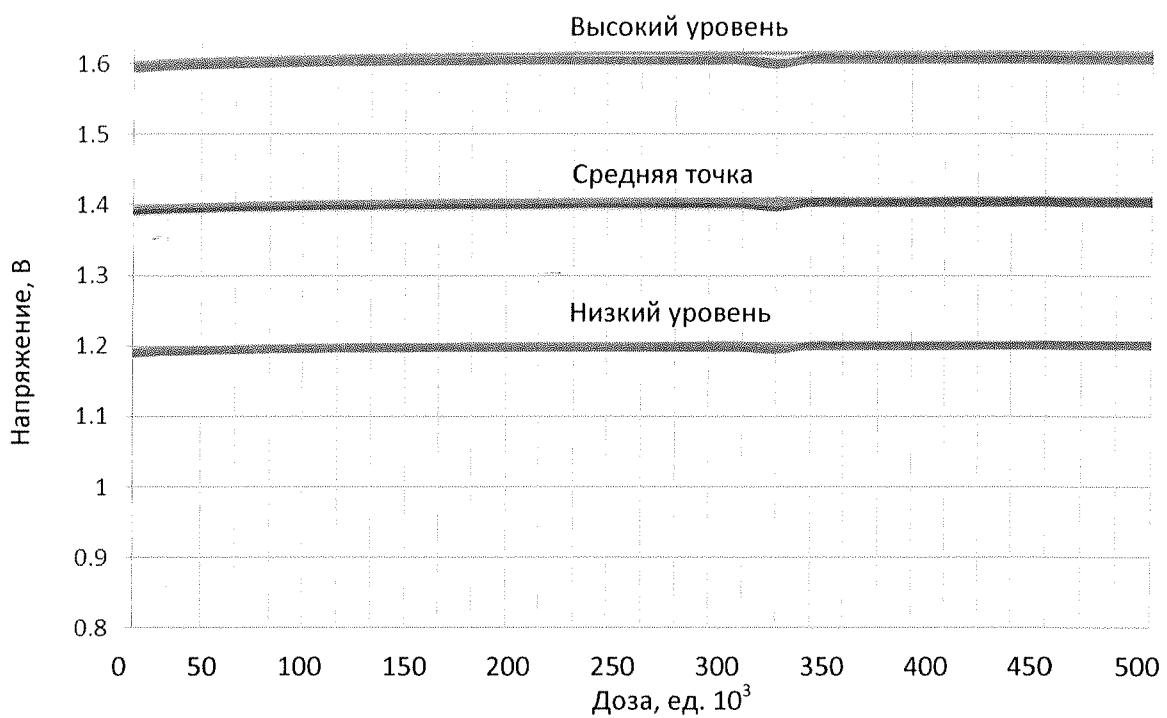


Рисунок 20 – Зависимости уровней выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,63$ В

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
И.И.И	Из.А.И.И			

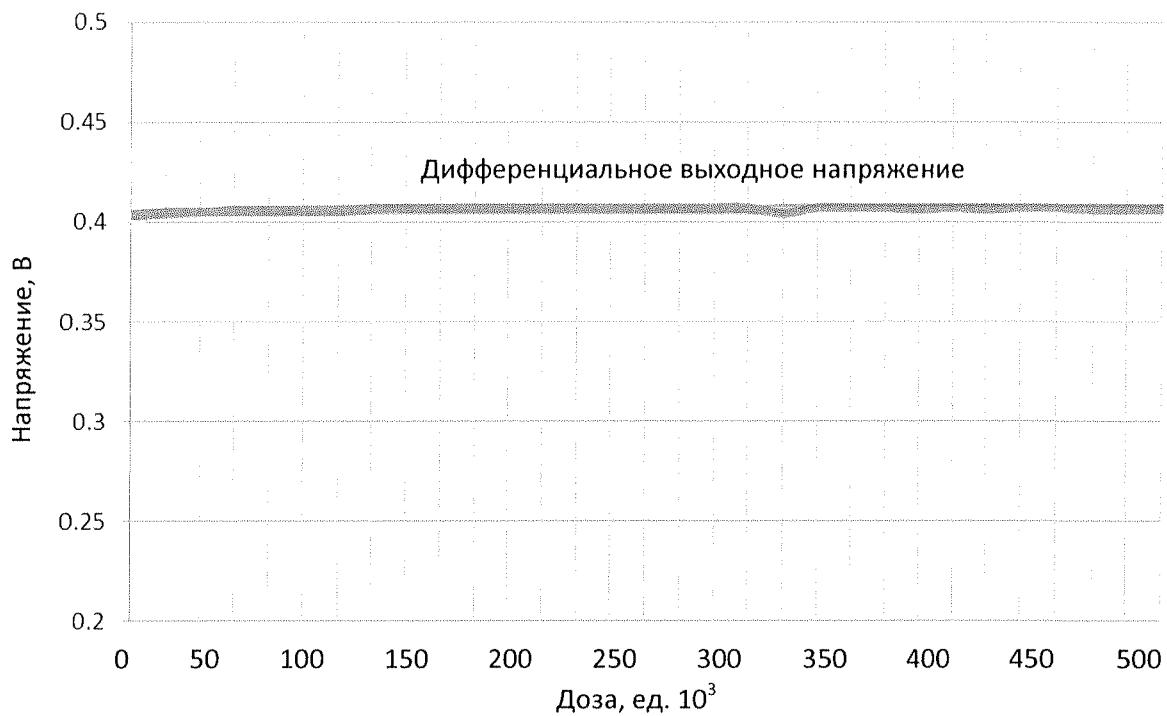


Рисунок 21 – Зависимости дифференциального выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,63$ В

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
ГАВЛ 17.07.2016	ГАВЛ 17.07.2016			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.021Д1	Лист
						28

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц)	№ документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Подл. и дата
ГАВЛ.431268.021Д1	Ильин, О.Ю.		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.021Д1

Лист

29